

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

深圳市英唐智能控制股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华福证券、浩期资产、长城基金、东方基金、东方阿尔法基金、太平资产、太平养老保险股份有限公司、天弘基金管理有限公司、信达澳亚基金、大成基金
时间	2025年11月26日
地点	电话会议
接待人员姓名	英唐智控董事长：胡庆周先生 英唐智控总经理：蒋伟东先生 唐智控董事会秘书：李昊先生 光隆集成实控人：彭晖先生 光隆集成总经理：陈春明先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、基本情况介绍 公司董事长胡庆周先生为投资者介绍了英唐智控的发展历程及发展现状，英唐智控深耕电子元器件分销，构建全球多区域网络，覆盖主芯片、存储、射频、显示驱动、功率/模拟器件、MEMS传感器及被动器件等全品类，积累了丰富的客户资源。自研芯片聚焦MEMS微振镜与车载显示芯片，通过加大研发投入、引进高端人才实现技术突破。公司已在多家头部屏厂成功导入车载显示芯片业务，首款车规级TDDI/DDIC的量产落地，多款改进型产品也在按计划推进流片、试产中。 胡庆周介绍公司与汽车配件厂合作开发的激光扫描投影（LBS）技术应用。相比当前高端车型多采用大功率光源实现车前方地面投影互动，LBS技术可实现彩色、高分辨率、远焦距小型化投影，体积小可嵌入360度任意位置，支持实时清晰成像，不同路面条件下保持稳定，允许用户上传个性化内容，结合传感器与手势识别，实现丰富车内外交

	互场景。该技术已与多家厂商交流，客户兴趣强烈。 近期筹备并购桂林光隆集成与上海奥简微电子，旨在强化光通信芯片、模拟集成电路领域布局，与现有分销及自研业务形成协同效应，借助生成式AI、大模型训练及云计算的爆发式发展，OCS市场有望迎来更大的发展机遇，明确未来将构建以光、电、算技术闭环为核心的芯片设计制造企业，加速构建半导体全产业链能力。 二、提问交流环节 1. 公司目前的经营情况怎么样？ 董事会秘书李昊答：公司分销业务稳健发展，芯片设计制造业务持续投入中。公司前三季度公司研发费用同比增长 90.06%，核心是加码显示芯片投入, 主要包括引进人才组建高素质研发团队，并在技术、项目验证上加大资金倾斜。短期内研发投入会对利润规模产生影响，长期将为业绩增长蓄能。 2. OCS MEMS方案相比其他技术路线有哪些优势？ 光隆集成实控人彭晖答:MEMS方案基于微机电工艺,通过电压控制反射镜（整镜）转角实现光路切换。切换速度几十毫秒，响应较为迅速，插入损耗约3dB，信号传输损耗相对较小，主要应用于大规模数据中心，与高速光模块、光环形器或双向WDM器件构成一个高效率、低成本、高效益的大规模光交换系统。 3. 光隆集成的ocs技术路线来自哪里？ 光隆集成实控人彭晖回答：公司产品技术来自国家级科研院所，光隆集成始终专注于光开关（OCS）相关技术研发，在机械式、MEMS微机械式、磁光式、电光式及波导式等多种控制方式上均有长期布局。光隆集成在光芯片领域拥有全制程技术能力，基于MEMS技术的OCS(光路交换机)系统与英唐智控在MEMS微振镜领域形成技术共创。 4. ocs业务在光隆集成的占比大概是多少？未来希望发展到什么程度？ 光隆集成总经理陈春明回答：目前，OCS业务在公司营收中的占比尚处于逐步提升阶段。公司对OCS业务的未来发展充满信心，随着市场需求的持续释放,公司希望OCS业务能在全全球相关市场需求占据一定
--	--

	份额，当然，目标的实现需要一定的时间积累和市场拓展。 具体来看，公司OCS产品已经达到量产状态，目前产品主要以小通道系列为主，大通道系列产品预计在明年一季度到二季度推出。公司正持续投入，在产品系列丰富（计划推出更多系列产品）、供应链保障（物料、设备等）以及产能建设等方面为更大规模的量产做好充分准备，以抓住未来的市场机遇。 5. 光隆集成的ocs芯片的生产良率是什么水平？ 光隆集成总经理陈春明回答：目前处于行业内的良好水平，公司对良率提升持续保持积极投入，通过工艺优化、技术迭代和生产经验的不断积累，推进良率向更高目标迈进，以进一步提升产品竞争力和盈利能力。 6. 光隆集成ocs业务的客户主要有哪些？ 光隆集成总经理陈春明回答：公司OCS业务客户结构多元，终端客户广泛覆盖海内外市场。依托与英唐智控的战略合作，凭借英唐智控丰富的客户资源，可以拓展海外市场，提升供应链响应效率与市场拓展能力，为客户创造更全面的价值。 8. 请简单介绍一下光隆集成ocs量产的情况？ 光隆集成总经理陈春明回答：目前ocs产品中32×32、64×64、96×96的通道规格已达量产状态，128*128通道的正处于量产准备阶段，预计明年一季度到二季度之间有望量产。英唐智控拥有完整的MEMS生产线，双方计划尽快在MEMS阵列的Fab生产领域展开合作，以加速相关产品的量产进程。
风险提示	公司发行股份及支付现金购买资产事项涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在被暂停、中止或取消的风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	参与单位名称
日期	2025年11月26日